

<<电子产品装接工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子产品装接工艺>>

13位ISBN编号：9787302187936

10位ISBN编号：7302187932

出版时间：2009-1

出版时间：清华大学出版社

作者：范泽良，龙立钦 编

页数：326

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子产品装接工艺>>

内容概要

电子产品的质量一方面取决于电子技术；另一方面取决于电子产品的装接工艺。

《电子产品装接工艺》从最基础的工艺知识入手，结合当前广泛应用的装接工艺，循序渐进地介绍了电子产品的工艺技术，由此来提高读者对电子产品装接工艺的实际应用能力。

全书共12章，内容不仅包括电子产品装接工艺的基础知识，装接常用工具和仪器仪表的使用方法，电子材料与元器件，印制电路板的设计与制造，装配的准备工艺，电子产品的装联、焊接、装配、组装技术，调试工艺以及电子产品技术文件等，还设置了万用表装调实例，帮助读者对全书主要内容进行巩固。

另外，书中的部分章节配有相应的实训项目，供读者选用。

《电子产品装接工艺》没有较深的理论知识，主要侧重于工艺过程的详细讲解，读者只需具备基本的电路理论和电子技术知识就可以轻松阅读。

《电子产品装接工艺》适合作为职业院校电子、信息类专业的专业基础课教材和“无线电装接工”技能的培训教材，也可供电子类相关专业的学生以及相关的从业人员参考使用。

<<电子产品装接工艺>>

书籍目录

第1章 电子产品装接工艺基础1.1 对电子产品的基本要求1.2 电子产品的可靠性1.3 电子产品的防护本章小结习题1第2章 装接常用工具和仪器仪表的使用2.1 常用工具的使用2.2 万用表2.3 直流稳压源2.4 信号源2.5 示波器2.6 电子电压表本章小结习题2第3章 电子材料与元器件3.1 电子材料3.2 R、L、C元件3.3 半导体器件3.4 集成电路3.5 表面组装元器件3.6 其他常用器件本章小结习题3实训项目：电子元件的检测第4章 印制电路板设计与制造4.1 印制电路板的基础知识4.2 印制电路板的设计4.3 印制电路板的制造工艺4.4 印制电路板的手工制作本章小结习题4实训项目：印制电路板的手工制作第5章 装配准备工艺5.1 导线的加工工艺5.2 浸锡工艺5.3 元器件引脚的成型工艺本章小结习题5实训项目：手工浸锡练习第6章 电子产品装联技术第7章 焊接技术第8章 电子产品装配工艺第9章 表面组装技术（SMT）第10章 电子产品调试工艺第11章 电子产品技术文件第12章 万用表装调实例附录A 常规元件的型号及命名附录B 半导体器件的型号及命名附录C 电工仪表代表符号的含义附录D 电子电气设备的常用文字符号参考文献

<<电子产品装接工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>